

植球助焊剂WS-823

简介

植球助焊剂WS-823是一款无卤的水洗型植球助焊剂，配方是专门为针转移植球到基板（BGA制造）的工艺而设计的。因其出色的流变特性，即使是最小的、靠重力法形成的落球也非常适合使用此助焊剂。**WS-823**的活性很强，可以极好地润湿大部分麻烦的金属化表面。**WS-823**直接用去离子水（DI）就能清洗干净。

特点

- 无卤
- 助焊剂的流变性使其适用于所有尺寸
- 适用于无铅工艺
- 长时间也可保证一致的针转移性能
- 低空洞率
- 植球制程中的高良率（不错失球）
- 各种基板表面上的可焊性极好
- 仅用去离子水（DI）就可清洗干净

行业标准测试结果和分类

助焊剂类别	ORH0*	*结果以最初的实验室数据为准。最终结果待审定。
IPC J-standard-004A测试法测定		
根据IEC 61249-2-21的EN14582测试法无卤	<900 ppm Cl <900 ppm Br <1,500ppm 总量	



属性

属性	数值	测试方法
典型黏度	18kcps (5分钟)	Brookpeld HB DVII +-CP (5rpm)
典型酸值	90 mg KOH/g	滴定法
粘性	250g	J-STD-005 (IPC-TM-650: 2.4.44)
保质期	室温下3个月*	黏度变化/显微镜检查

*初步结果。数据仍在收集中。

所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

包装

植球助焊剂WS-823有6盎司的罐装和12盎司的筒装。

清洗

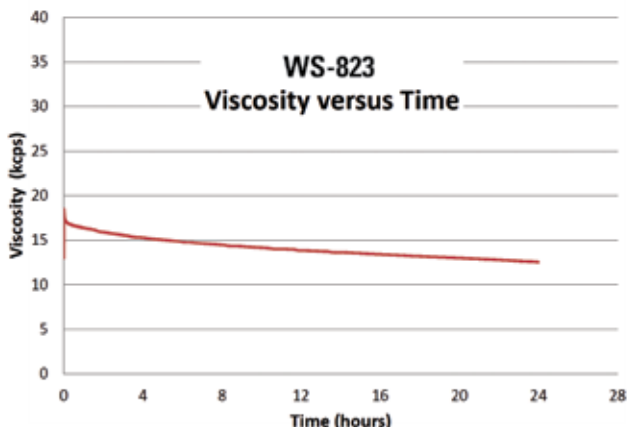
WS-823可用去离子水（DI）和添加了清洗剂的水溶液清洗。喷雾清洗的理想条件为：20-30℃温度下，用超过60psi的压力冲洗超过1分钟。



植球助焊剂WS-823

应用

WS-823的沉积量可通过调整设备参数来优化。关键参数包括：针的形状、针的直径、剪切速度、滞留时间和浸渍的深度。助焊剂的流变性则可通过剪切达到理想的黏度而实现优化。



储存

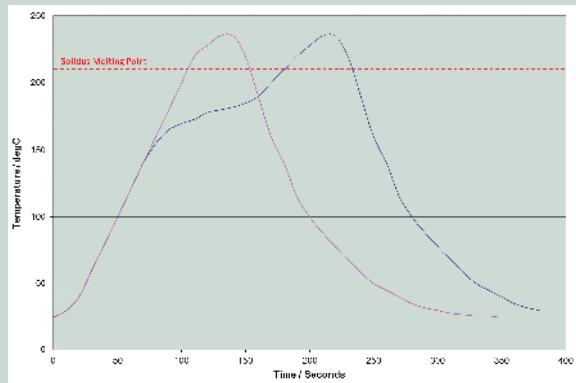
为了保证达到其最长的保质期，筒装WS-823应尖头朝下储存在温度-20°C到+5°C的环境中。温度绝对不能超过31°C。应至少提前4小时从冷藏环境中取出，使其能在使用前达到室温。

技术服务

钢泰公司的技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其全球范围内的快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

回流

推荐的温度曲线 (SAC305)



不超过45秒的短时间预热（150-160°C）处理可以帮助减少空洞。温度曲线的理想状态是采用线性升温速度1-2°C/秒升温至超过液相线温度20到30°C左右，然后快速降温，在降至液相线温度之前的时间最少为20秒。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: china@indium.com
更多详情: www.indiumchina.cn, www.indiumm.com



中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2018 Indium Corporation